

SL-SMT 5.08HC/04/90LF 3.1SN BK BX SO

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com



Изображение аналогичное

Термостойкий штекерный соединитель, упаковка — коробка или лента. На ленте и с выводами под пайку 1,5 мм оптимизирован для автоматического монтажа. Длина выводов 3,2 мм подходит для пайки волной припоя и оплавлением сквозных отверстий (Reflow). Штекерные соединители обеспечивают место для маркировки и допускают кодирование. HC = сильнотоочный.

Основные данные для заказа

Исполнение	Штекерный соединитель печатной платы, Штырьковый соединитель, Фланец под пайку, Соединение THT/THR под пайку, 5.08 mm, Количество полюсов: 4, 90°, Длина контактного штифта (l): 3.1 mm, луженые, черный, Ящик
Номер для заказа	1171080000
Тип	SL-SMT 5.08HC/04/90LF 3.1SN BK BX SO
GTIN (EAN)	4032248963119
Кол.	100 Шт.
Продуктивное отношение	IEC: 400 V / 27.5 A UL: 300 V / 18.5 A

Упаковка: Ящик

Дата создания 7 апреля 2021 г. 6:25:32 CEST

Состояние поставки Снято с производства

Доступно до 2019-10-31

Статус каталога 12.03.2021 / Право на внесение технических изменений сохранено.

SL-SMT 5.08HC/04/90LF 3.1SN BK BX SO

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

Технические данные

Размеры и массы

Высота	11,6 мм	Высота (в дюймах)	0,457 inch
Высота, мин.	8,5 мм	Глубина	12 мм
Глубина (дюймов)	0,472 inch	Масса нетто	3,67 g
Ширина	30,12 мм	Ширина (в дюймах)	1,186 inch

Упаковка

Упаковка	Ящик	Длина VPE	65 мм
VPE с	105 мм	Высота VPE	130 мм

Системные характеристики

Серия изделия	OMNIMATE Signal — серия BL/SL 5.08	Вид соединения	Соединение с платой
Монтаж на печатной плате	Соединение THT/THR под пайку	Шаг в мм (P)	5,08 мм
Шаг в дюймах (P)	0,2 inch	Угол вывода	90°
Количество полюсов	4	Количество контактных штырьков на полюс	1
Длина контактного штифта (l)	3,1 мм	Допуск на длину выводов под пайку	0 / -0,3 мм
Размеры выводов под пайку	d = 1,2 мм, восьмиугольный	L1 в мм	15,24 мм
L1 в дюймах	0,6 inch	Количество полюсных рядов	2
Объемное сопротивление	≤5 mΩ	Кодируемый	Да
Циклы коммутации	25	Усилие вставки на полюс, макс.	9 N
Усилие вытягивания на полюс, макс.	7 N		

Данные о материалах

Изоляционный материал	LCP GF	Цветовой код	черный
Таблица цветов (аналогич.)	RAL 9011	Группа изоляционного материала	IIIa
Сравнительный показатель пробоя (CTI)	≥ 175	Прочность изоляции	≥ 10 ⁸ Ω
Moisture Level (MSL)	1	Класс пожаростойкости UL 94	V-0
Материал контакта	CuMg	Поверхность контакта	луженые
Структура слоев соединения под пайку	1...3 μm Ni / 2...4 μm Sn матовый	Структура слоев штепсельного контакта	1...3 μm Ni / 2...4 μm Sn матовый
Температура хранения, мин.	-40 °C	Температура хранения, макс.	70 °C
Рабочая температура, мин.	-50 °C	Рабочая температура, макс.	100 °C
Температурный диапазон монтажа, мин.	-30 °C	Температурный диапазон монтажа, макс.	100 °C

SL-SMT 5.08HC/04/90LF 3.1SN BK BX SO

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmuller.com

Технические данные

Номинальные характеристики по IEC

пройдены испытания по стандарту	IEC 60664-1, IEC 61984	Номинальный ток, мин. кол-во контактов (Tu = 20 °C)	27,5 A
Номинальный ток, макс. кол-во контактов (Tu = 20 °C)	19 A	Номинальный ток, мин. кол-во контактов (Tu = 40 °C)	24 A
Номинальный ток, макс. кол-во контактов (Tu = 40 °C)	16,5 A	Номинальное импульсное напряжение при категории помехозащищенности/ Категория загрязнения II/2	400 V
Номинальное импульсное напряжение при категории помехозащищенности/ Категория загрязнения III/2	320 V	Номинальное импульсное напряжение при категории помехозащищенности/ Категория загрязнения III/3	250 V
Номинальное импульсное напряжение при категории помехозащищенности/ Категория загрязнения II/2	4 kV	Номинальное импульсное напряжение при категории помехозащищенности/ Категория загрязнения III/2	4 kV
Номинальное импульсное напряжение при категории помехозащищенности/ Категория загрязнения III/3	4 kV		

Номинальные характеристики по CSA

Номинальное напряжение (группа использования В/CSA)	300 V	Номинальное напряжение (группа использования D/CSA)	300 V
Номинальный ток (группа использования В/CSA)	18,5 A	Номинальный ток (группа использования D/CSA)	18,5 A

Номинальные характеристики по UL 1059

Институт (UR)		Сертификат № (UR)	E60693
Номинальное напряжение (группа использования В/UL 1059)	300 V	Номинальное напряжение (группа использования D/UL 1059)	300 V
Номинальный ток (группа использования В/UL 1059)	18,5 A	Номинальный ток (группа использования D/UL 1059)	10 A
Ссылка на утвержденные значения	В технических характеристиках приведены максимальные значения, подробные сведения см. в сертификате об утверждении.		

Важное примечание

Соответствие IPC	Заявление о соответствии: все изделия разрабатываются, производятся и поставляются в соответствии с установленными международными стандартами и нормами и соответствуют характеристикам, указанным в технической документации, а также обладают декоративными свойствами в соответствии с IPC-A-610, "Класс 2". Любые другие запросы информации об изделиях могут быть рассмотрены по запросу.
Примечания	<ul style="list-style-type: none"> • Позолоченные контактные поверхности по запросу • Номинальный ток указан для номин. сечения и мин. числа контактов. • Диаметр монтажной петельки D = 1,4+0,1 мм • Диаметр монтажного отверстия под пайку D = 1,5 + 0,1 мм, для 9 контактов • R на чертеже – шаг • Расчетные данные относятся к соответствующему компоненту. Воздушные зазоры и пути утечки к другим компонентам должны быть сформированы согласно соответствующим стандартам, регламентирующим применение. • Длительное хранение продукта при средней температуре 50 °C и средней влажности 70%, 36 месяцев

SL-SMT 5.08HC/04/90LF 3.1SN BK BX SO

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

Технические данные

Сертификаты

Сертификаты



ROHS

Соответствовать

UL File Number Search

E60693

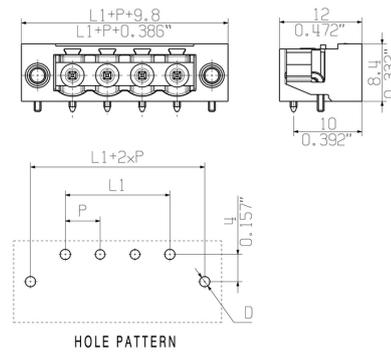
SL-SMT 5.08HC/04/90LF 3.1SN BK BX SO

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
 Klingenbergstraße 26
 D-32758 Detmold
 Germany

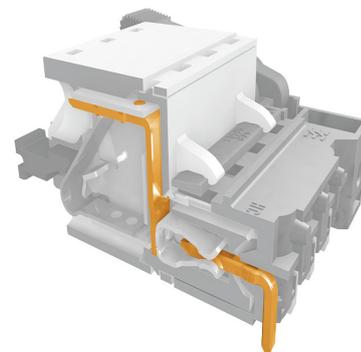
www.weidmueller.com

Изображения

Dimensional drawing



Преимущество изделия



Safe power transmission
 Proven properties

Recommended wave soldering profiles

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
 Klängenbergstraße 16
 D-32758 Detmold
 Germany
 Fon: +49 5231 14-0
 Fax: +49 5231 14-292083
 www.weidmueller.com

Single Wave:



Double Wave:



Wave soldering profiles

Wired connection elements should be processed in accordance with the DIN EN 61760-1 standard. We have included two recommendations for practical wave soldering profiles, with which Weidmüller PCB terminals and connectors are qualified.

When choosing a suitable profile for your application, the following factors also need to be considered:

- PCB thickness
- Proportion of Cu in the layers
- Single/double-sided assembly
- Product range
- Heating and cooling rates

The single and double wave profiles each indicate the recommended operating range, including the maximum soldering temperature of 260°C. In practice, the maximum soldering temperature is quite often well below the above maximum profile.

Recommended reflow soldering profile

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
 Klingenbergstraße 16
 D-32758 Detmold
 Germany
 Fon: +49 5231 14-0
 Fax: +49 5231 14-292083
 www.weidmueller.com



Reflow soldering profile

The perfect soldering profile for SMT Surface Mount Technology is one the most exiting question in SMT production. But there are more than one correct answer: The diagram of temperature-on-time is related to processing features of solder paste and to maximum load of components.

We have to consider the following parameters:

- Time for pre heating
- Maximum temperature
- Time above melting point
- Time for cooling
- Maximum heating rate
- Maximum cooling rate

We recommend a typical solder profile with associated process limits. With preheating components and board are prepared smoothly for the solder phase. Heating rate is typically $\leq +3\text{K/s}$. In parallel the solder paste is ‚activated‘. The time above melting point of 217°C the paste gets liquid and components and boards begin to connect. The maximum temperature of 245°C to 254°C should stay between 10 and 40 seconds. In the cooling phase at $\geq -6\text{K/s}$ solder is cured. Board and components cool down while avoiding cold cracks.